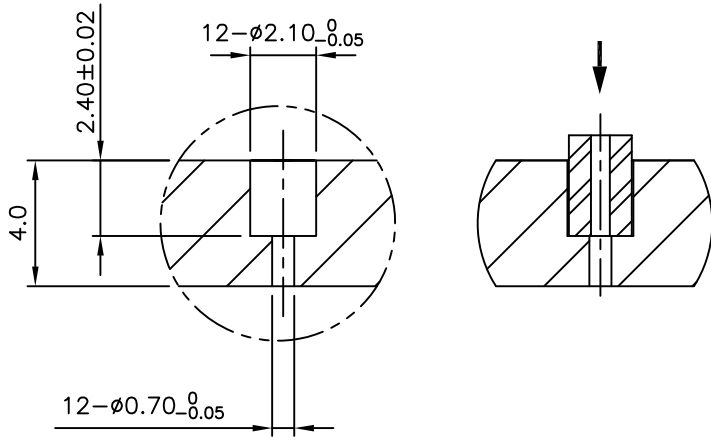
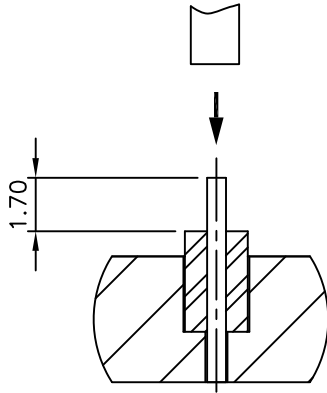


■조립방법 (JIG : DEQ01173-5/2 / 아래 치수 부위 사용)

<STEP 1> 절연체 삽입



<STEP 2> 핀셋 이용하여 핀 삽입 후 하이스핀으로 핀 끝까지 삽입



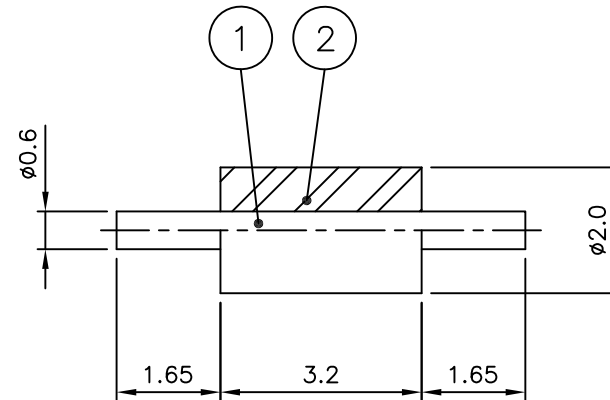
* 조립 후 검사 주의사항

1. PIN+절연체 조립시 헐겁지 않게 관리 필요.

(발주 진행 시 PIN 한도 견본을 절연체 외주 가공업체에 전달하여
조립 후 길이나 절연체가 헐겁지 않게 관리 될 수 있도록 내용 전달 필요.)

REVISION

REV	DESCRIPTION	DRAWN	APPR	DATE
IR	Initial Registration	S.H.KIM		2024.03.07.



2	INSULATOR	1	TEFLON		DIN02927-N/E
1	CONTACT	1	MBsBD C3604BD-F	Gold Plate	DCT03914-5/C
NO.	DESCRIPTION	Q'TY	MATERIAL	PLATING	CODE

TOLERANCE	Decimal ±0.2	DATE 2024. 03. 07.			 RF & MICROWAVE TECHNOLOGY Tel : 82-32-347-8015 Fax : 82-32-347-8017 KJ COMTECH CO.,LTD.		
	Angle ±1°	APPROVED BY					
MATERIAL _____		CHECKED BY			TITLE BUSHING		
		DRAWN BY S.H.KIM					
FINISH _____		SCALE 8/1	UNIT mm		A4	DWG NO. CN03890-7/G	
						REVISION	I R